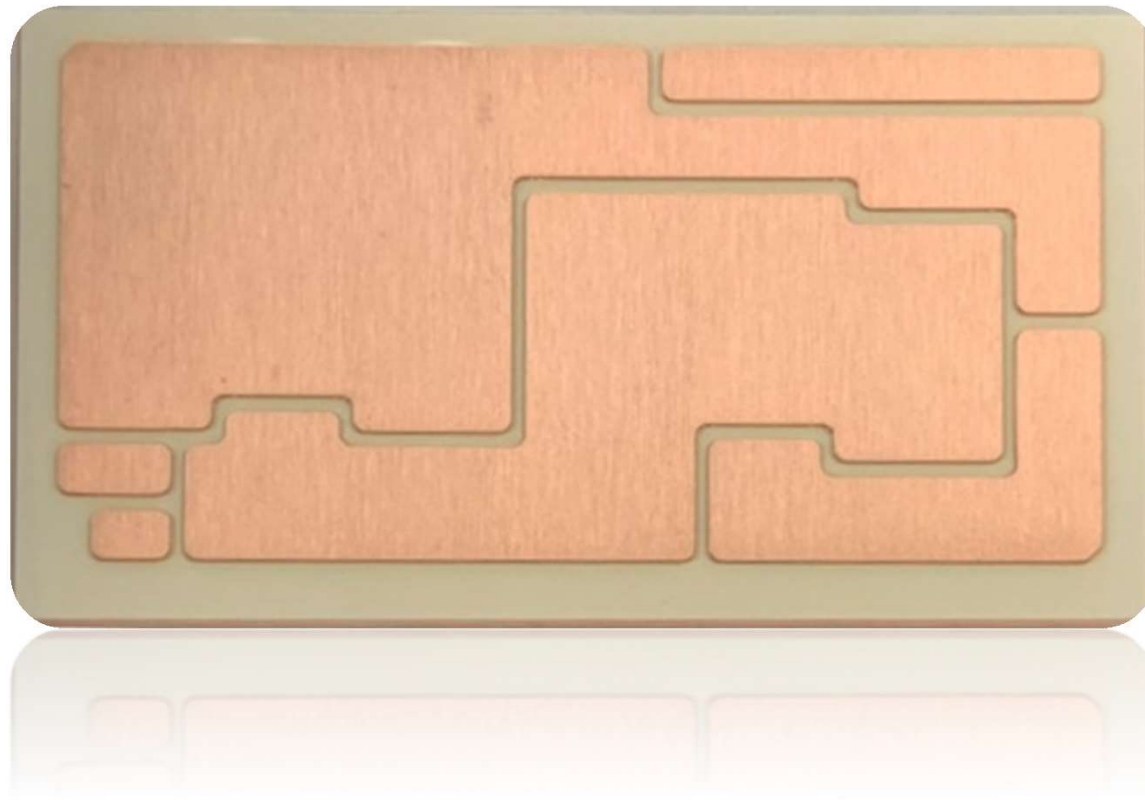


【500 μ m厚銅】パワーデバイス向け厚銅基板

～『熱伝導率12W/(m·k)の高放熱性』と『高絶縁性』を有する基板～



『金属基板に求められる放熱特性』



アルミベース基板
熱伝導率 $7\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$
車載LEDヘッドランプ等

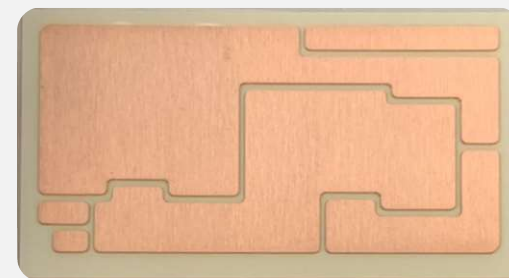


アルミベース基板
熱伝導率 $3\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$

LED照明器具等



厚銅基板
熱伝導率 $12\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$
パワーデバイス等
(DBC基板代替想定)



層構成例(イメージ)

回路銅層 $500\mu\text{m}\sim$

絶縁樹脂層 $125\mu\text{m}$ または $175\mu\text{m}$

銅ベース層 2.0mm

『厚銅基板の特長』

1. 構造(資料掲載サンプル)

★熱伝導率 $12\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ を実現しました。

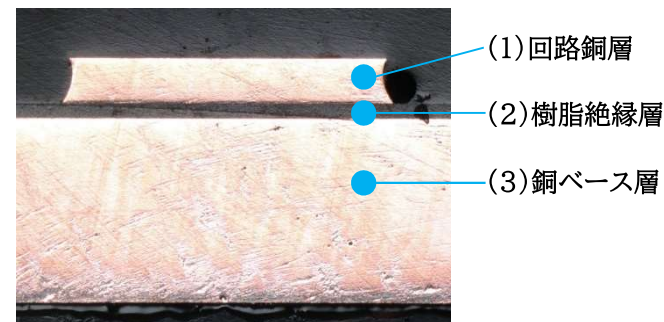
★銅ベース層による鉛直方向への熱拡散と、回路層による水平方向への熱拡散の2種類の放熱ができるため、基板全体での熱拡散性に優れます。

(1)回路銅層厚み : $500\mu\text{m}$

(2)樹脂絶縁層厚み : $125\mu\text{m}$ または $175\mu\text{m}$

(3)銅ベース層厚み : 2.0mm

■標準基板構造(パターン部断面図)



2. 加工

★高精度／高エッチングファクタの回路形成が可能です。

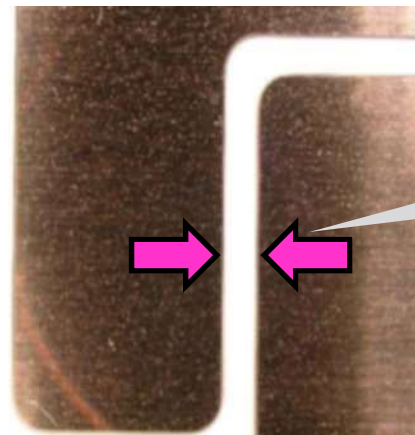
*回路間隔 1mm

*基本管理公差 $+0.2/-0.2\text{mm}$

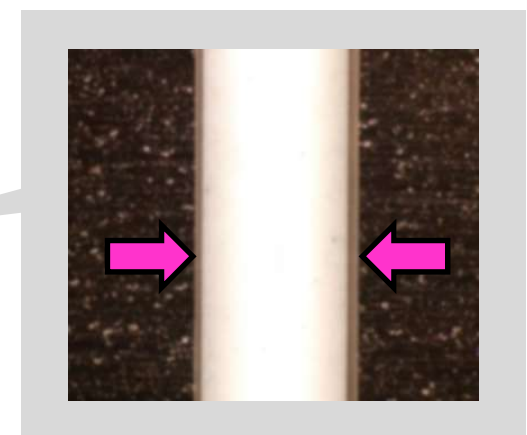
3. 材料

★当該基板は高放熱樹脂絶縁材料を採用しています。

■パターン間ピッチ部写真

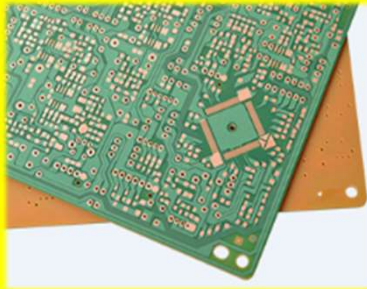


■パターン間ピッチ部写真(拡大図)



『京写製品ラインナップ』

生産量
世界ナンバーワン

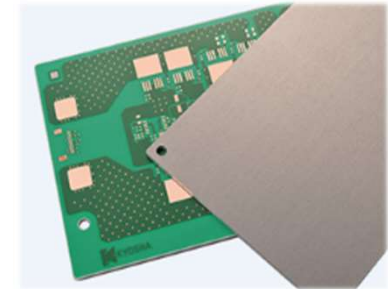


片面基板

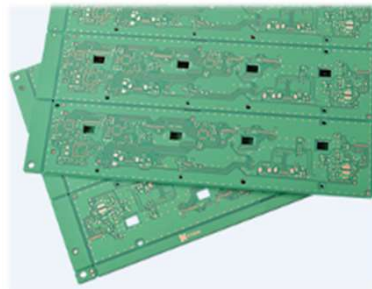
京写はプリント基板に関する
開発・設計・試作・量産を
トータルサポートします。
お気軽にご相談ください。

京写

検索



メタルベース基板



両面・多層基板



ペースト基板

